

烟台德邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技

证券代码：688035

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	中银国际、长江证券、博时基金、中信证券
时间	2024年11月18-21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰 公司证券总监：战世能 公司证券事务代表：翟丞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司前三季度经营情况？</p> <p>答：2024年前三季度公司实现营业总收入7.84亿元，同比增长20.48%，其中集成电路和智能终端两个板块增速明显，新能源虽然受降价影响增幅仍达到两位数增幅比例，高端装备板块同比微增，各板块营收均保持持续增长趋势。</p> <p>2024年前三季度公司净利润同比有所下降，主要原因一是供应链有一部分产品降价，二是2024年实施限制性股票激励计划，确认相关股份支付费用。虽然利润端面临一定的挑战，但公司通过大宗采购议价、技术</p>

降本、智能制造等措施积极应对，努力提升盈利水平，并积极拓展客户增加利润增长点。得益于上述措施，公司净利润的同比降幅较前两季度有所收窄，公司仍在不断努力进一步提升盈利水平。

2、集成电路板块今年以来增长情况？

答：经过多年的技术和市场积累，公司在集成电路封装材料板块已形成了丰富多元的产品线，整体解决方案的能力不断增强。今年以来包括 UV 膜系列、固晶系列、导热系列等现有成熟产品均实现较好的增长，其中用于 SSD 固态硬盘的导热材料今年取得突破，通过了国际头部客户验证并实现批量供货。今年半导体行业有所复苏但是幅度不是太大，公司集成电路板块前三季度增长达到三成以上，整体好于行业水平。与此同时，公司还有多款芯片级封装材料在客户端持续的推进导入上量，目前 DAF 膜已在部分客户实现量产出货，CDAF 膜、AD 胶、Underfill 材料实现部分客户小批量交付，TIM1 材料获得部分客户验证通过，正在推进产品导入。在先进封装材料领域，公司具备一系列成熟技术并能实现批量供货，这些新产品也为公司集成电路板块的增长带来更多的增长机会和空间。

3、智能终端板块增长较快的原因？

答：公司智能终端板块前三季度同比增长了大几十

个点，一方面是消费电子市场同比好于去年，另一方面是公司产品在终端客户新品中的导入带来了份额提升，如苹果的新款 TWS 耳机、iPad、Vision Pro 等，安卓品牌厂商的份额也都在提升，尤其是小米今年新推出小米 15 手机，公司为其“LIP0 立体屏幕封装技术”提供关键材料，另外公司切入的车载电子方面的应用带来了增量。智能终端板块技术门槛相对较高，具有产品迭代快，研发投入高的特点，公司紧跟客户需求，持续加大产品开发投入的资源 and 力度，凭借本土化的响应能力和商务优势，增加和客户的粘性，提升公司产品市场占领份额。

4、新能源板块今年的情况？

答：公司动力电池用双组分聚氨酯封装材料已在众多动力电池头部客户实现批量供货，市场份额保持领先，虽然受新能源部分产品降价影响，利润面临一定的挑战，但公司通过一系列积极举措在提升新能源应用材料的盈利水平方面取得一定成效。同时积极实施国际化战略，拓展海外优质客户。

在储能电池应用方面，公司已向多个行业头部客户批量供货，并配合客户开发高性价比产品，巩固和扩大公司在储能电池应用领域的市场份额。

在光伏领域，公司产品目前主要应用于光伏叠瓦组件，也可应用于 TOPCon、HJT 等新兴光伏电池技术领域。另外公司基于 0BB 技术研发的焊带固定材料，目

前已通过多个行业头部客户验证，实现批量供货。

5、高端装备应用材料有什么大的增长机会吗？

答：公司高端装备板块基数相对较小，公司今年增长点在于新能源汽车结构粘接、机电电控、轻量化等应用的增量，公司积极拓展在新能源汽车制造行业、轨道交通行业、工程机械行业、智慧家电行业、军工设备行业、电动工具行业以及冶金矿山行业等领域的业务布局和应用推广，进一步拓展了公司业务版图。

6、公司收购衡所华威终止的原因？

答：本次收购的终止是交易对方单方面提出的，对此公司也进行了披露，具体详见公司披露的相关公告。

7、公司是否有其它并购的考虑？

答：并购是企业快速发展、扩张的重要方式之一，公司也始终关注行业发展动态，积极探寻市场上潜在的优质电子封装材料企业，希望通过并购方式助力企业做大做强。

公司主营业务是电子封装材料，业务板块包括集成电路、智能终端、新能源、高端装备，目前在集成电路和智能终端领域，大部分材料仍被国外友商垄断，国产化替代迫在眉睫。在并购目标的选择方向上，公司将围绕现有主业，聚焦国内相对薄弱、市占率低的领域积极

	<p>推进。</p> <p>8、大基金方面关于退出是如何考虑的？</p> <p>答：公司股东大基金（国家集成电路产业投资基金）持有的公司首发前股份已于 2023 年 9 月 19 日解禁，截至目前大基金尚未减持公司股份。公司不了解大基金的具体退出计划，公司股东减持如涉及相关信息披露，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无